

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-050

南京晶升装备股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资

金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,111.68万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	112,491.64
其中：超募资金金额	54,010.00
减：直接支付发行费用	10,861.24
二、募集资金净额	101,630.40
减：	
以前年度已使用金额	22,161.73
本半年度使用金额	0.10
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	27,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.06
其他-永久补充流动资金	55,669.75
加：	
募集资金利息收入	366.02
其他-闲置募集资金现金管理收益	4,246.90
三、报告期期末募集资金余额	1,111.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月29日，为配合公司经营管理需要，提高募集资金的管理效率，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专

户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 4 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	-	已注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	42.98	使用中
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	-	已注销
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	1,068.70	使用中
晶升半导体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	-	已注销

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月28日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

2026年4月9日，公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间		2023 年 4 月 17 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
55,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 28 日
40,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2026 年 4 月 9 日	2027 年 4 月 8 日	2026 年 4 月 9 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 4 月 17 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026 年 4 月 24 日	2026 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 23 日	3,000.00	1.80%	13.50
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026 年 4 月 24 日	2026 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	3,000.00	1.85%	/
晶升半	南京银	结构性	保本浮	3,000.00	2026 年 4	2027 年 1	2027 年 1	3,000.00	1.85%	/

导体	行 股 份 有 限 公 司 南 京 紫 东 支 行	存款	动收益		月 24 日	月 19 日	月 19 日			
晶 升 半 导体	南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 紫 东 支 行	结 构 性 存款	保本浮 动收益	10,000.00	2026 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 2 日	2027 年 4 月 2 日	10,000.00	1.85%	/
晶 升 股 份	南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 珠 江 支 行	结 构 性 存款	保本浮 动收益	8,300.00	2026 年 6 月 10 日	2026 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	8,300.00	1.85%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募集资金投资项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”总投入募集资金金额的情况下，公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币20,255.00万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起，至募集资金投资项目实施完成之日止，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。

为优化晶升半导体的资产负债结构，增强其资金实力，支持其良性运营和可持续发展，公司于2026年1月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将对晶升半导体提供的人民币20,255.00万元的募集资金借款转为对晶升半导体增资以实施募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-006）。

2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额

置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更，项目和投资用途未变更。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账日期							2023 年 4 月 17 日						
本半年度投入募集资金总额							8,529.54						
已累计投入募集资金总额							70,161.83						
变更用途的募集资金总额							0.00						
变更用途的募集资金总额比例							0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
总部生产及研发中心建设项目	生产建设	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	0.00	20,551.89	-6,813.50	75.10	2025 年 3 月	7,739.40	否	否
半导体晶体生	生产建设	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.10	1,609.94	-18,645.06	7.95	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

长设备总装测试厂区建设项目													
承诺投资项目小计	/	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	0.10	22,161.83	-25,458.56	46.54	/	/	/	/
超募资金	/	/	54,010.00	54,010.00	不适用	8,529.44	48,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			101,630.39	101,630.39	/	8,529.54	70,161.83	/	—	—	/	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				由于《南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》无法按预期计划实施，若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期，故为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，拟对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”进行延期及变更。公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》，对该项目的实施地点及实施方式进行变更，并将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，对该项目的实施地点进行变更。 公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》。 受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。 截至本报告披露日，上述项目用地出让手续及项目建设方案公示已完成，正在办理施工许可证和施工单位招标。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“是否达到预计效益”为“否”是因为前期行业扩产需求放缓，市场价格竞争激烈，虽报告期内下游需求呈回暖趋势，但本期确认收入的订单较少，且订单价格偏低，致使募投项目未能达到预计效益。